



H6100 导热凝胶

H6100 是一款单组份有机硅导热凝胶产品，可采用自动化点胶，尤其适合于对长期垂直可靠性以及高效散热有需求的应用场景。其独特的配方设计赋予该材料特有的柔软和低应力，能够确保器件在使用过程中不受到任何损伤。H6100 在客户端使用时无需再次进行混合和固化，方便操作。

产品描述

产品特性

条目	描述
外观	灰绿色膏体
组分	单组份
工作温度	-50~150℃

产品优点

- 出色的可靠性，适用于垂直应用场景
- 高导热率 10.0 W/m·K
- 可自动化点胶，操作简单
- 柔软，低应力
- 低析油率
- 符合 RoHS 标准

典型运用领域

- 微处理器及芯片
- 汽车电子控制单元
- 无线通讯
- 内存和电源模块
- 电源及半导体
- 光模块



产品典型特性

产品性能

条目	典型值	备注
密度 g/cm^3	3.2	GB/T 13354
挤出率 g/min	32	30ccEFD, 90PSI
典型最小贴合厚度 mm	0.25	ASTM D5470
析油率 %	1.2	125°C@48h
导热系数 $\text{W/m} \cdot \text{K}$	10	ASTM D5470
热阻 Kcm^2 / W	0.38	ASTM D5470 @50psi
介电强度 KV/mm	6	ASTM D149
体积电阻 $\Omega \cdot \text{cm}$	$> 10^{13}$	ASTM D257
RoHS2.0	符合	/
UL94	V0	/

标准包装

- 300ml / 支
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。防潮，建议储存环境湿度不高 60%。防晒，建议避光储存，存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：8-28℃，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。



注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区诸园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com